

인용발명1:한국공개특허 제1999-88521호(1999.12.27) 1부.

יְהוָה יְהוָה יְהוָה

1999-0086521

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(54) Int. C.^o

(11) 공개번호 특1999-0088521
(43) 공개일자 1999.12.27

11) 종합번호	10-1999-0018752
12) 출판일자	1999년05월25일
13) 저작권주	10-144557 1998년05월26일 일본(JP)
14) 저작자	안도영키 가부시키기이사 니끼무리 쇼오
15) 출판자	일본국 도쿄도 오타구 기마타 4초메 19번7고 우치노요시이카
16) 저작권자	일본국도쿄도오타구기마타4초메19번7고 구니노보세이이자
17) 저작권자	일본국도쿄도오타구기마타4초메19번7고 미문희, 이정훈

(54) 제15장 치료학적 진단과 치료학적 조작기법

한문집내에 빼치된 피씨점장치를 축정기에 전기적으로 전송하기 위한 전송부재와, 그로부터 상기 피씨점장치를 그 속성상으로 반송하는 반송장치와, 피씨점장치의 리마인드에 접속시키는 접속부재와, 판통하는 부록구멍을 갖고, 그 부록구멍에는 풍선통과 접속부지가 부착되고, 상기 피씨점장치의 리마인드가 접속부자의 전송된 때에 접속되어, 타단이 상기 힙온존 내부의 공기중에 접속되어 있는 구조.

5. 17. 4. 그들은 제1인시에 따른 고운현대화의 축적구조를 나타내는 단면도로서, IC를 IC축정기로 축적하는 단면도를 나타내는 도면.

5. 1990년 1월 1일 이전에는 관할 행정구조를 나타내는 단면도로서, IC소켓상에 IC를 반입해 온 상태를 나타내

5-4) 그림과 함께 예상한 고온화탄소의 구조를 나타내는 단계도

1978년 11월 10일 (한국 주교회의 설교)

1. 대형도서관	1a. 리아드
2. 대형도서관	2a. 접촉자
3. 대형도서관	4. 접촉암증부재
4. 대형도서관	5. 방염불륨
5. 대형도서관	6. 물수함

제 2 장 고온증정기능부학의 기본과 그 보야의 증정기법

② 농촌 피복 경정치에 접속하는 농업부채의 일환으로부터 흡수되어서, 농업부채를 전도하여 농부부채의 디딤돌로 부터 철옹조내를 순환하는 공기중에 방출된다.

제3장서 **피속정장치에 전유가 흘러서 피속정장치가 말립하고 피속정장치의 온도를 한온조내의 온도에 균온화시키기 위해서는 상장치의 옥외정조안이 일정한 온도범위내로 피속정장치의 온도를 유지할 수가 있다.**

그리고 3. 3D 디스플레이 기술을 활용한 운도병위내에서의 피속정장치의 전기적 특성의 측정이 가능하게 된다.

그리고 날씨부분은 전 층부재에 대해 상하방향으로 미동가능한 상태로 보석시키고, 이 전 층부재가 상기 고속도로의 라인을 만족하는 상태에 있어서, 병행부재가 자체증량에 의해 피속점증치율을 만족한 상태로 상기 고속도로에 적합한 기준이다.

본 발행인은 주식 장당의 구조에 따르면, 전 출부지에 대해 상하방향으로 이동 가능한 상대로 방출부지지를 부착시키고, 방출부지가 교류정장치의 리아드를 일속한 상태에 있어서, 방출부지가 자체증량에 의해 교류정장치를 확장하는 구조에서 교류정장치에 접속하는 구조으로 했기 때문에 교류정장치로부터 방출부지로의 연계

방법부재를 상기 접촉부재에 대해 리이드의 압축방향으로 미동 가능한 상태로 부착시킴과 동시에, 접촉부재에 미동하는 상기 리이드의 압축방향으로 상기 방열부재를 험화시키는 용수출을 부착시키고, 접촉부재에 미동하는 상기 접촉부재의 리이드를 압축한 상태에 있어서, 상기 방열부재가 상기 용수출의 가하는 힘에 의해 상기 접촉부재를 상기 접촉부재에 대해 고정시킨다.

그러나 그 뒤 소비자의 구조에 따르면, 접속부제에 대해서 살기 암흑방향으로 이동가능한 상태로 방송부제를 살기 암흑방향으로 방송부제에 대하여 헛을 기하는 등수첩은 접속부제의 부적구멍의 내용을 살피는 것이다.

102-4. 전동부제에 의해 피드정장치의 리이드가 압축된 상태에서, 방열부제는 용수첨의 가하는 힘에 의해 리이드를 확장시켜 압축된 피드정장치에 진출가능하게 된다.

그리고 러시아 관리들로부터 방열부재로의 열전도성이 높여진다.

방법부(方偏部)는 방법부(方偏部)의 다른 단위에 복수의 유효(遞凸)이 혼성된 방법부를 구성할 수 있고, 방법부는 한

제 1771: 출입구의 구조에 따른다. 방음문제가 다른 단면에 물수의 유통을 끌어온다면 차운

▲ 2019년에는 세종문화 폐용점장과 출점기, 편스토파, 밤수제과, 민식수제과의 점포들이 신설되었다.

부칙부령이 형성되어 있으며, 부칙부령에는 높은 명전도성을 갖는 방역부재가 부착되어 있다.

제작자: 김민수 감독: 김민수 출연: 김민수, 김민수, 김민수 등

마지막으로, 내부부문에 따른 평가를 정점에서 다른 평가를 받은 조조의 경지에 접속된다.

그러므로 이후 미처 예상치 못한 경기적 특성을 협정한 운동법칙에서 축정할 수 있다. 예상되는 운동법칙은 운동법칙을 구성하는 구조로 구성된다.

제 11 항. 제 1 항 및 제 2 항에 정한 조건을 갖춘 자에게는 그에 대한 허가를 부여한다.

이제는 그만한 힘으로는 그를 제거하지 못할 것 같군.

도시화 도시는 광소에서 본 탐방의 실시에 따른 고온한 풀러, 즉, 고온시험기능을 갖는 오트엔들러를
기장에 설치해 운영된다.

설명은

도시화 도시는 탐방의 제1의 실시현대에 따른 고온한 풀러의 층정구조를 나타내는 단면도이다.

도시화 도시는 탐방기기에 의해 층정하는 상태를 나타내고, 도 2는 IC소켓상에 IC를 반송해온 상태를 나타내고 있다.

도 1의 도 2에 대하여, 1은 IC, 즉, 퍼퓸장장치이고, 2는 IC소켓, 즉, 접속부재로서의 소켓이며, 3은 반송장치이며, 4는 접속부재로서의 접속입출부재, 5는 방열부재로서의 방열블록이다.

도시화 제1의 고온한 풀러는 퍼퓸장장치인 IC(1)를 기울여 고온환경에서의 전기적 특성을 층정하는 고온화장장을 구비한다.

도시화 제1은 IC(1)를 IC(2)에 반송하는 배수 같이 퍼퓸장장치인 IC(1)와, IC축정기기를 접속하는 IC소켓(2)과, IC(2)에 반송하는 반송장치(3)와, IC(1)의 리미드(1a)를 접속해서 리미드(1a)를 접속자(2a)에 접속시키는 접속입출부재(4)와, IC(1)와 접속해서 IC(1)의 방열블록(5)을 방열하는 방열블록(5)을 구비하고 있다.

도시화 제1은 접속입출부재(4), 및 방열블록(5)은 일정온도로 유지된 항온조(도시상탁)의 내부에 배치되어 있다.

도시화 제1은 항온조의 대입을 IC(1)의 반송에 수반하여 이동한다.

도시화 항온조의 내부는 기울기 등에 의해 가동된 공기를 향에 의해 순환시키므로서 일정온도로 유지되고 있다.

도시화 제1은 항온조에 풍공부(2b)를 갖고 있으며, 그 풍공부(2b)내에는 IC(1)의 리미드(1a)에 접속하는 IC(1)과 그 대신자 않은 IC축정기의 사이의 전기적 인터페이스(interface)를 형하는 접속자(2a)를 구비하고 있다.

도시화 제1은 IC(1)을 위치를 정해서 유지하는 유지부(3a)를 구비하고, 그 하단면에는 수용하는 IC(1)의 대입(1b)을 아래쪽으로부터 노출시키는 접속부(3b)가 형성되어 있다.

도시화 제1은 도시하지 않은 미동기구에 의해 항온조의 내부를 왕복이동하고 동시에 도시하지 않은 승강기구에 의해 사용하고 상하에서 IC소켓(2)에 접속되고 분리된다.

도시화 제1은 IC(1)에 접속된 IC(1)의 리미드(1a)는 상기 접속부(3b)를 거쳐 IC(1)의 대입(1b)에 접속된다.

도시화 제1은 IC소켓(2)의 대입하는 위치에 배치되어서, 도시하지 않은 승강기구에 의해 상하방향으로 이동된다.

도시화 제1은 접속부(3b)는 IC(1)에 리미드 상호간의 단락을 방지하기 위해, 예를들면 합성수지와 같은 절연재로 형성된다.

도시화 제1은 접속부(3b)는 그 하단에 리미드(1a)를 접속해서 리미드(1a)를 접속자(2a)에 접속시키는 접속부(3b)로, IC(1)의 대입(1b)과 접속부(3b)의 거의 중앙에는 상하방향, 즉, 접속방향으로 관통하는 부착구멍(14b)이 형성되어 있다.

도시화 제1은 부착구멍(14b)에는 접속입출부재(14)에 대하여 상하방향으로 슬리미드 이동 가능한 접속부(3b)로 형성된다.

도시화 제1은 접속부(3b)는 특수의 요철에 의해 넓은 표면력을 갖는 방열부(5a)가 설치되어 있다.

도시화 제1은 단체 단밀화한 하단표면(5b)은 IC(1)의 상단 표면에 접속되도록 설치되어 있다.

도시화 제1은 접속입출부재(14)가 도 2의 상태인 상승한 상태에 있어서, 그 방열부(5a)가 접속입출부재(14)에 접속해서 접속부(3b)를 상승시키는 한편, 접속입출부재(14)가 도 1과 같은 상태, 즉, 하강한 상태에서는 그 접속부(3b)를 상승시켜서 IC(1)의 상단면에 맞닿아서 일어울려진다.

도시화 제1은 접속부(3b)가 하강한 상태에 있어서, 방열블록(5)은 자체증량에 의해 IC(1)의 상단면을 압축하는 접속부(3b)로 상승시킨다.

도시화 제1은 접속부(3b)로 부터 IC(1)의 탈출에도, 그 열은 몇당하는 방열블록(5)의 하단면(5b)으로부터 방열하기 위한 방열부(5a)로부터 항온조내를 순환하는 공기통으로 효율적으로 방열된다.

도시화 제1은 접속부(3b)를 항온조내의 설정온도에 균질시킬 수가 있다.

도시화 제1은 고온전들러의 층정구조의 동작에 대해 설명한다.

도시화 제1은 IC(1)가 도시하지 않은 미동기구에 의해 미동해서 항온조 외부의 IC(1)를 항온조 내부의 IC(1)로 대입하는 위치 속, 도 2의 위치로 반송한다.

도시화 제1은 항온조내의 공기는 순환해서 일정한 온도로 유지되고 있고, 이 공기의 접속되는 IC(1)도 일정한 온도로 유지된다.

도시화 제1은 액체에 있어서, 반송장치(3)가 도시하지 않은 승강기구에 의해 하강해서 반송장치(3)의 접속부(3b)가 IC(1)의 접속부(3b)대로 퍼워넣어지고, 반송장치(3)와 IC소켓(2)이 결합된다.

10-5-1) 본 장부 10-5에 수용되는 IC(1)의 리아드(1a)는 첨부(3b)를 거쳐서 IC소켓(2)의 접촉자(2a)상에 놓인다.

반송구조(3)와 IC소켓(2)가 결합한 후, 접속암출부재(14)가 승강기구에 의해 하강해서 접속암출부재의 암축부(14a)가 IC(1)를 압축해서 리아드(1a)를 접촉자(2a)에 접촉시킨다.

이때, 반송구조(3)는 자체증강에 의해 IC(1)의 상단면을 일축한 상태에서 IC(1)의 상단면에 맞닿는다. 그리고 두 IC(1)에 있어서, IC축점기에 의해 IC(1)의 전기작동성이 측정된다.

이어서 IC(1)에 전기적 특성을 측정하기 위해 전류가 흐르고, 이에 의해 IC(1) 자체가 팔열된다.

그리고 IC(1)에 접속한 IC(1)의 상단면에 달당는 방열불록(5)의 하단면(5b)으로부터 절연되어서, 방열불록(5)은 IC(1)의 방열부(5a)로부터 같은 조건을 순환하는 공기중으로 효율적으로 방열된다.

다만, IC(1) 자체의 발광에 의한 IC(1)의 온도상승이 예상되어, 어떤 일정한 온도범위내에서 IC(1)을 절연시켜야 한다.

그러면 IC(1) 자체의 발광의 제1설시예의 고온밸러리에 따르면, 접속암출부재(14)의 암축방향으로 판별하는 방열부(5a)에는 높은 열전도성이 갖는 방열불록(5)이 부착되어 있어, 접속암출부재(14)가 IC(1)의 리아드(1a)를 접촉한 상태에 있어서, 상기 방열불록(5)의 하단면(5b)이 IC(1)의 상단면에 맞닿는 한편 상단면의 방열부(5a)가 활용조(내부)를 순환하는 공기중에 배치되어 있기 때문에, 예를들면, IC(1)의 전기적 특성을 측정하면서 동시에 올려서, IC(1)에 전류가 흐르려면 IC(1)가 팔열해도 그 옆은 IC(1)에 달당는 방열불록(5)으로부터 흡수되어서, 방열불록(5)으로 전도되어 방열부(5a)의 방열부(5a)로 전도되고 그 순환하는 공기중으로 방열된다.

마지막 IC(1)의 진류를 끌려서 IC(1)가 팔열해도 IC(1)의 온도를 활용조내의 온도로 균정시켜서 IC(1)의 온도를 수상한 활용한 온도범위내로 IC(1)의 온도를 유지할 수가 있고, 상기 일정한 온도범위내에서의 IC(1)가 전기작동의 유통이 가능해진다.

5-2) 접속암출부재(14)에 대해서 상하방향으로 이용가능한 상태로 방열불록(5)을 부착시키고, 접속암출부재(14)가 IC(1)의 리아드(1a)를 접촉한 상태에 있어서, 방열불록(5)이 자체증강에 의해 IC(1)를 접촉한 상태에 대해서 IC(1)에 맞닿는 그선으로 헛기 때문에 IC(1)로부터 방열불록(5)으로의 열전도성이 높아진다.

마지막 IC(1) 자체의 공기중에 배치되는 방열불록(5)의 일단면에 특수의 유통이 형성된 방열부(5a)를 습식하여 IC(1)에 IC(1)로부터 출수한 암은 방열부(5a)로부터 활용조내를 순환하는 공기중으로 효율적으로 방열된다.

5-3) 접속암출부재(14)에 따른 고온밸러리의 유통구조를 나타내는 단면도이다.

이전단면과 유사구조는 도 30에 나타내는 바와 같이, 접속부자로서의 IC소켓(22), 반송장치(23), 접속부자부설의 접속암출부재(24), 방열부자로서의 방열불록(25), IC소켓(22)에 대해서 방열불록(25)을 일률 가이드 조사(26)로 구성되어 있다.

제2단면에서는 도 30에 나타내는 바와 같이 지면에 대해 수직으로 놓인상태에서 IC(1)의 전기적 특성을 측정한다.

제2단면은 도 30에 도시하지 않은 제1설시예와 같이 온도가 일정하게 유지되고 있는 활용조내에 수직으로 배치된다.

접속암출부재(14) 및 방열불록(25)은 IC소켓(22)에 대향해서 배치되어 있다.

도 30본이상과 도 30에 있어서 접속된 증공부가 형성되어 있다.

도 30본이상과 도 30은 도시하지 않은 IC축점기 사امي의 전기적 인터페이스를 수행하기 위해 제1설시예와 제2단면과 주입구에 접속(26)을 구비하고 있다.

도 30본이상과 도 30은 리아드(1a)를 압축하여 리아드(1a)를 접촉자(22a)에 접촉시키기 위해 우측 단면에 암축부(24)는 기울여놓았다.

도 30본이상과 도 30에는 수평방향으로 판통하는, 즉, IC(1)을 압축하는 방향으로 부착구멍이 형성되어 있다.

도 30본이상과 도 30은 IC(1)에 접속된 IC(2)에 접속되고 분리되는 방향으로 수평으로 이동한다.

도 30본이상과 도 30은 IC(1)을 위치결정하고 유지하기 위한 유지부(23a)를 구비하고 있다.

도 30본이상과 도 30은 IC(1)의 리아드(1a)를 우측으로부터 노출시키기 위한 창부가 형성되어 있다.

도 30본이상과 도 30은 도시하지 않은 이동기구에 의해 활용조 내외간을 왕복 이동한다.

도 30본이상과 도 30은 도시하지 않은 이동기구에 의해 IC소켓(22)에 걸이맞추어지거나 분리되도록 수평으로 기울여놓았다.

방울부자로서의 IC소켓(22)에 정속한 상태에서 IC(1)에 수동된 리아드(1a)는 첨부를 통해서 IC소켓(22)의 암축부(24)를 기울여놓았다.

방열불록(25)은 제1설시예와 같이 접속암출부재(24)의 부착구멍에 판통하는 상태로 부착되어 있다.

방열불록(25)은 예를들면 우수한 열전도성을 갖는 금속으로 형성된다.

방열불록(25)은 용수와 유험부의 넓은 표면적을 갖는 좌우 단말부에 방열부(25a)를 구비하고 있다. 방열부(25a)는 방열구멍의 내벽에는 용수철(26)이 배치되어 있다.

방열구멍(24)의 일정은 접촉압축부재(24)에 접속되어 있고, 한편, 타단은 방열불록(25)에 접속되어 있다.

방열부록(25)은 IC소켓(22)의 방향, 즉, 용수철(26)에 의해 IC(1)를 압축하기 위한 방향으로 힘의 가해져 있다.

접촉압축부재(24)가 IC소켓(22)으로부터 분리된 상태에서 방열불록(25)의 방열부(25a)는 접촉압축부재(24)의 단단한 배치되어 있고, 접촉압축부재(24)가 IC(1)의 리미드(1a)에 접속된 상태, 즉, 도 30에 나온 것과 같이 IC(1)의 방열부(25a)의 반대측인 방열불록(25)의 우측 단말 표면은 IC(1)의 접촉 단말 표면에 접촉된다. 접촉부재(24)의 가로는 힘의 방향으로 일정히 확장된다.

접촉부재(24)가 IC(1)의 리미드(1a)에 접속된 상태에서, 방열불록(25)은 용수철(26)의 가하는 힘에 의해 IC(1)의 단단한 표면을 압축하면서 방열불록(25)에 대칭하고 있는 IC(1)의 단단한 표면에 접촉되어 있다.

따라서, IC(1)의 방향에 전류가 흐르면 IC(1)가 말열하려도 그 옆은 방열불록(25)의 IC(1)에 접속된 단단한 표면에 의해 속도되고, 방열부(25a)로부터 할온조내를 순환하고 있는 공기에 효율적으로 방열된다.

따라서 IC(1)의 방향에 의한 온도상승을 억제하는 것이 가능하고, 일정한 온도범위내에서 IC(1)를 측정하는 것이 가능하다.

기존 시장의 고온한 물리의 측정구조의 동작은, IC소켓(22), 반송장치(23), 접촉압축부재(24) 및 방열불록(25)과 고온방열부록(26)으로 이동할 수 있고, IC(1)가 용수철(26)의 가하는 힘에 의해 방열불록(25)에 접속되는 것을 제외하고는 제1접시에의 그것과 거의 동일하다.

본 발명(3)은 IC(1)를 할온조의 외부로부터 할온조 내부에서 IC소켓(22)에 대합하여 IC(1)의 위치까지 이동하여 IC(1)를 속도하고 같은 이동기구에 의해 이동된다.

본 발명(3)은 이동기구에 의해 우측으로 이동하면 반송장치(23)의 우측 단말부는 IC소켓(22)의 중공부(22b)로 접속된다.

반송장치(23)는 IC(1)를 할온조의 외부로부터 할온조 내부에서 IC소켓(22)에 대합하여 IC(1)은 상호 결합된다.

이제 IC(1)의 리미드(1a)는 첨부를 통해서 IC 소켓(22)의 접촉자(22a)상에 놓여진다.

그리고 IC(1)의 리미드(1a)는 이동기구에 의해 우측으로 이동되고, 그러면 접촉부(24a)가 리미드(1a)를 접촉하는 것을 통해 IC(1)를 접속된다.

마지막으로 접촉부(24)는 용수철(26)의 가하는 힘에 의해 압축되면서 IC(1)의 접촉단말 표면에 접촉된다.

이제 IC(1)에 도 30에 나온 바와 같이, IC(1)의 전기적 특성이 IC측정기기에 의해 측정된다.

이제 IC(1)를 속도하기 위해 IC(1)에 전류가 흐르면 IC(1)는 열을 발생시킨다.

마지막으로 IC(1)의 접촉 단말은 방열불록(25)의 IC(1)의 접촉 단말 표면에 접속된 우측 단말 표면에 의해 흡수된다.

마지막으로 IC(1)을 통해 전도되고, 방열불록(25)의 방열부(25a)로부터 할온조내를 순환하는 공기에게 흡수되는 열을 공급된다.

마지막으로 IC(1)의 방향에 의한 온도상승을 억제하는 것이 가능하고, 일정한 온도범위내에서 IC(1)를 측정하는 것이 가능하다.

기존 시장의 고온한 물리의 제2접시에의 고온한 물리에 따르면, 방열불록(25)은 접촉압축부재(24)에 대해 접촉부(24a)로 IC(1)를 속도하고, 방열불록(25)은 접촉방향으로 힘을 가하기 위한 용수철(26)은 접촉부(24a)로 IC(1)을 부착되어 있다.

마지막으로 IC(1)에서 접촉압축부재(24)가 IC(1)의 리미드(1a)에 접속되면, 방열불록(25)은 용수철의 가하는 힘에 의해 IC(1)을 압축하면서 IC(1)에 접속되어 있다.

그리고 IC(1)은 전기적 특성이 IC(1)가 속으로 위치한 상태에서 측정되면, 발생된 열을 방열불록(25)을 통해 IC(1)에 각각의 전도시키는 것이 또한 가능하고, 발생된 열을 방열부(25a)로부터 할온조내를 순환하는 열을 통해 IC(1)를 속도하는 것이 가능해진다.

마지막으로 IC(1)를 속도하는 것이 가능해진다.

이제 IC(1)에서는 흡정장치로서 오른한 물리를 적용했으나, 흡정장치의 전기적 특성을 측정하는 다른 방법으로 적용 가능하다.

마지막으로 IC(1)를 속도하는 것은 아니고, 다른 전기장치에도 적용 가능하다.

마지막으로 IC(1)를 속도하는 것이 가능해진다. 전기적 특성의 측정시에 있어서의 흡정장치 자체의 힘에 의해 IC(1)를 속도하는 힘에 대해서 일정한 온도범위내에서의 흡정장치의 측정을 가능하게 한 흡정장치의 측정을 위한 힘을 제거하는 수단이 제공된다.

제 1항 1)

상기 인도 1) 우자원형운조내에 배치된 피측정장치를 축정기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와, 상기 창문 2) 외부로부터 상기 피측정장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 피측정장치의 리미드를 관리해서 상기 리미드를 상기 접속부재의 접속자에 접속시키는 접속부재를 구비하고 있으며,

상기 접속부재는 상기 접속방향으로 관통하는 부착구멍을 갖고 있으며, 상기 부착구멍에는 높은 열전도성(열전도성재료)이 부착되어 있고,

상기 접속부재가 상기 피측정장치의 리미드를 접속한 상태에서 상기 방열부재는 그 일단이 상기 피측정장치에 접속되고, 다른이 상기 핵운조 내부를 순환하는 공기중에 배치되는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 접속장치의 구조.

제 1항 2)

제 1항 3)

상기 접속부재가 접속으로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 축정장치의 구조

제 1항 4)

제 1항 5)

상기 방열부재를 상기 접속부재에 대해 상하방향으로 이동 가능한 상태로 부착시키고, 상기 접속부재가 상기 피측정장치의 리미드를 접속한 상태에 있어서, 상기 방열부재가 자체 증량에 의해 상기 피측정장치를 접속한 상태로 상기 피측정장치에 맞접하는 구조로 되어 있는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 접속장치의 구조.

제 1항 6)

제 1항 7)

상기 방열부재를 상기 접속부재에 대해 리미드의 압출방향으로 이동 가능한 상태로 부착시킴과 동시에 접속부재의 고정의 위치에 상기 리미드의 압출방향으로 상기 방열부재를 힘을 가하는 용수철을 부착시키고, 상기 방열부재가 상기 피측정장치의 리미드를 접속한 상태에 있어서 상기 방열부재가 상기 용수철의 가하는 힘에 의해 상기 접속장치를 접속된 상태에서 피측정장치에 맞접하는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 접속장치의 구조.

제 1항 8)

제 1항 9)

상기 방열부재는 냉열부재의 다른쪽 달릴에 복수의 요철이 형성된 방열부를 구비하고, 방열부는 핵운조내에 접속되는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 축정장치의 구조.

제 1항 10)

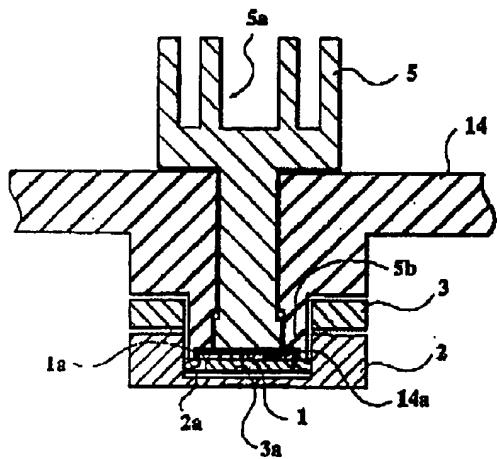
상기 인도 1) 우자원형운조내에 배치된 피측정장치를 축정기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와, 상기 창문 2) 외부로부터 상기 피측정장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 상기 피측정장치의 리미드를 관리해서 상기 접속부재의 접속자에 접속시키는 접속부재를 구비하고 있으며,

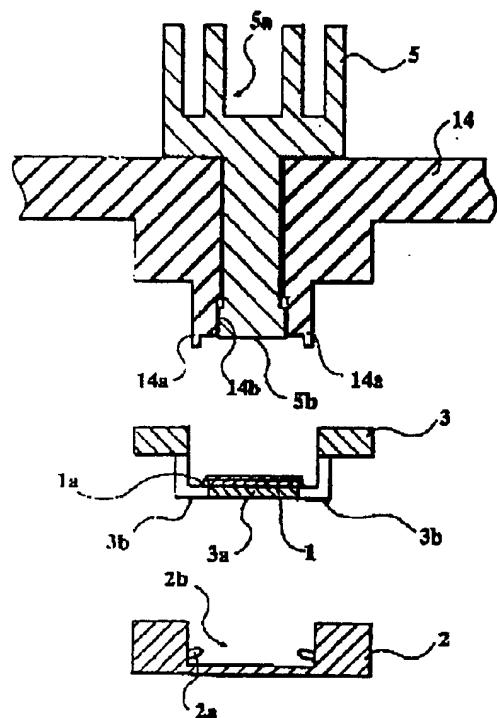
상기 접속부재는 관통하는 부착구멍을 갖고 있고, 상기 부착구멍에는 높은 열전도성(열전도성재료)이 부착되어 상기 접속부재의 접속자에 접속되고, 타단이 상기 핵운조 내부의 공기중에 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 접속장치의 구조.

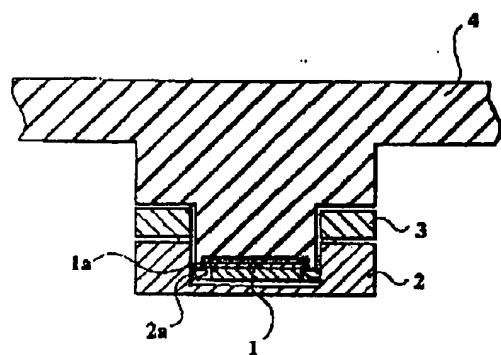
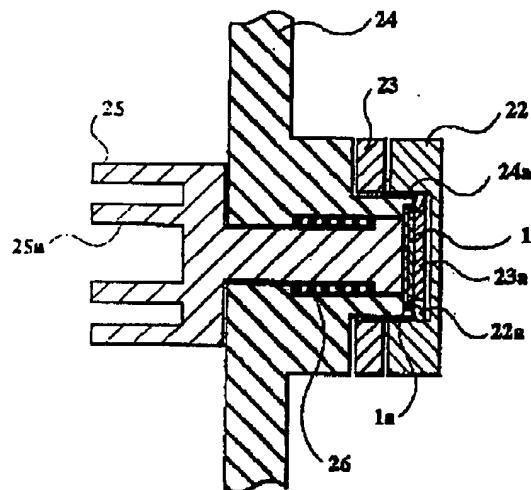
제 1항 11)

상기 인도 1) 우자원형운조내에 배치된 피측정장치를 축정기에 전기적으로 접속하기 위한 접속부재와, 상기 창문 2) 외부로부터 상기 피측정장치를 그 접속부재상으로 반송하는 반송장치와, 피측정장치의 리미드를 관리해서 상기 접속부재의 접속자에 접속시키는 접속부재를 구비하고 있으며,

상기 접속부재는 높은 열전도성을 갖는 방열부재가 부착되고, 상기 피측정장치의 리미드가 접속부재의 접속자에 접속되고, 타단이 상기 핵운조 내부의 공기중에 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 피측정장치를 축정하기 위한 접속장치의 구조.







**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.